

公司代码：688653

公司简称：康希通信



格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

2025年度，公司实现营业收入 68,333.84 万元，同比增长 30.71%，归母净利润-4,363.04 万元，减少亏损 3,249.70 万元，同比实现亏损收窄。归母净利润为负的主要原因为公司积极应对全球射频前端行业龙头企业提起的专利诉讼和 337 调查支付的律师费、专家费，以及高额研发投入等因素导致阶段性亏损。本年度公司研发投入仍然保持了较高水平，占营业收入的比重为 14.32%。随着 Skyworks 无条件撤回 337 调查和专利诉讼，公司涉及本次 337 调查和专利诉讼的事项全部终止；公司阶段性亏损状况将逐步改善。

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-4,363.04万元，公司母公司报表中期末未分配利润为1,494.93万元。鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	康希通信	688653	不适用

1.2 公司存托凭证简况

适用 不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭雅丽	陈玲
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）502室	中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）502室
电话	021-50479130	021-50479130
传真	不适用	不适用
电子信箱	kctzqb@kxcomtech.com	kctzqb@kxcomtech.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务的基本情况

公司是一家专业的射频前端芯片设计企业，采用 Fabless 经营模式，主要从事 Wi-Fi 射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。

射频前端（RFFE）作为无线通信的核心组成部分，承担着收发电磁波信号、放大信号强度、过滤干扰的关键职能，其性能直接决定了互联体验感与通信可靠性，是智能化浪潮中不可或缺的核心硬件基石。这类核心硬件是广泛应用于 Wi-Fi 通信、手机蜂窝通信（2G/3G/4G/5G）、蓝牙通信、ZigBee 通信等无线通信设备中的核心模块之

一，主要由功率放大器芯片（PA）、低噪声放大器芯片（LNA）、射频开关芯片（Switch）、滤波器芯片（Filter）等射频前端芯片构成。两种或两种以上芯片裸片合封在同一基板上，构成射频前端模组（FEM）。射频前端芯片及模组主要实现无线电磁波信号的增强放大、优化噪音及过滤干扰信号等功能。

Wi-Fi（Wireless Fidelity）是一种将电子终端设备以无线方式连接的局域网通信技术，凭借通信距离远、传输速率快、连接快速等优势，成为无线局域网通信中最普及、应用最广的技术，Wi-Fi 通信成为现代信息化、数字化社会不可缺少的基础要素。

公司主要产品为 Wi-Fi FEM，即应用于 Wi-Fi 通信领域的射频前端芯片模组。由公司自主研发的 PA、LNA 及 Switch 芯片集成，实现 Wi-Fi 发射链路及接收链路信号的增强放大、低噪声放大等功能。Wi-Fi FEM 的性能对用户使用 Wi-Fi 通信时的联网质量、传输速度、传输距离、设备能耗等具有重要影响。

公司产品广泛应用于家庭无线路由器、家庭智能网关、企业级无线路由器、AP 等无线网络通信设备领域及智能家居、智能蓝牙音箱、智能电表等物联网领域。Wi-Fi 协议标准的升级、频段的增加、MU-MIMO 等多通道技术的采用，推动 Wi-Fi FEM 单颗价值提升及单设备使用量增加。万物互联时代的到来，使得 Wi-Fi FEM 市场需求日益增加，其作用也愈来愈重要。

公司致力于研发高性能、高线性度、高可靠性的 Wi-Fi 射频前端芯片及模组，经过多年持续研发投入与技术积累，公司目前已形成 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 等完整 Wi-Fi FEM 产品线组合。目前公司 Wi-Fi 6/7 FEM 产品在线性度、工作效率等主要性能指标上，与境外头部厂商的同类产品基本相当，部分中高端型号产品的线性度、工作效率、噪声系数等性能达到行业领先水平。公司多款 Wi-Fi FEM 产品通过博通、高通、联发科、瑞昱等多家国际知名 Wi-Fi 主芯片（SoC）厂商的技术认证，纳入其发布的产品配置方案参考设计中，体现了公司较强的产品技术实力及行业领先性。

为提高全球市场占有率，公司早期便组建专业海外业务团队，积极拓展具有发展潜力的海外市场。公司研发的 Wi-Fi 6/7 产品凭借优异的性能与具有竞争力的价格优势，迅速赢得海外运营商的青睐。相关产品已通过上述国际知名 SoC 厂商的参考设计认证，为公司突破海外市场奠定了坚实稳固的基础。随着海外市场的不断拓展，公司全资研发子公司自 2024 年上半年开始遇到了全球射频前端行业龙头企业对公司子公司提起专利诉讼及 337 调查。2026 年 1 月 23 日（美国时间），337 调查获得美国国际

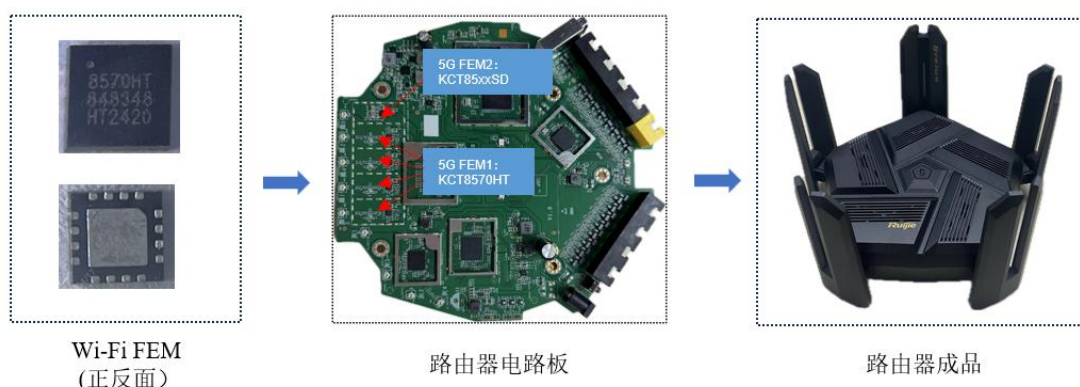
贸易委员会（USITC）法官的初审裁决，公司全资研发子公司没有任何知识产权侵权行为。随着初步裁定的阶段性胜利，境外客户对公司产品的自主创新性充满信心。2026年4月24日（美国东部时间），公司获悉 ITC 行政法官决定基于撤诉协议，终止 Inv. No.337-TA-1413 案件调查。同时，Skyworks 也向美国加州中区联邦地区法院对处于中止状态的专利诉讼提出撤诉，并获得法院的同意。至此，Skyworks 已无条件撤回 337 调查和在美国加州中区联邦地区法院的专利诉讼，公司涉及本次 337 调查和专利诉讼的事项全部终止。

2025 年，公司持续深耕 Wi-Fi 技术领域，Wi-Fi 7 系列产品表现抢眼，通过不断迭代升级，细分市场份额稳步增长，Wi-Fi 7 产品收入占营业收入比超 50%。公司在射频前端芯片相继获得高通、联发科、博通等国际知名 SoC 厂商 Wi-Fi 7 平台参考设计认证的基础上，Wi-Fi 7 订单持续放量，市场需求旺盛。基于对下一代无线通信标准的前瞻布局，公司已于 2025 年开始了 Wi-Fi 8（IEEE 802.11bn）产品的研发。2026 年召开的 CES 2026、MWC 2026 等国际展会均将 Wi-Fi 8 列为焦点技术，博通、联发科、高通先后推出自家的 Wi-Fi 8 SoC 主芯片，公司将持续保持与各大平台厂商的深度互动与技术交流，在 2028 年行业 Wi-Fi 8 技术标准发布之前，抢占 Wi-Fi 8 产品技术高地。目前公司已有多款 Wi-Fi 8 产品展开了与上述多家国内外知名 Wi-Fi 主芯片 SoC 厂商技术对接参考设计的认证工作，预计 2026 年推出支持该协议的样品，配合主芯片公司抢占行业发展先机。

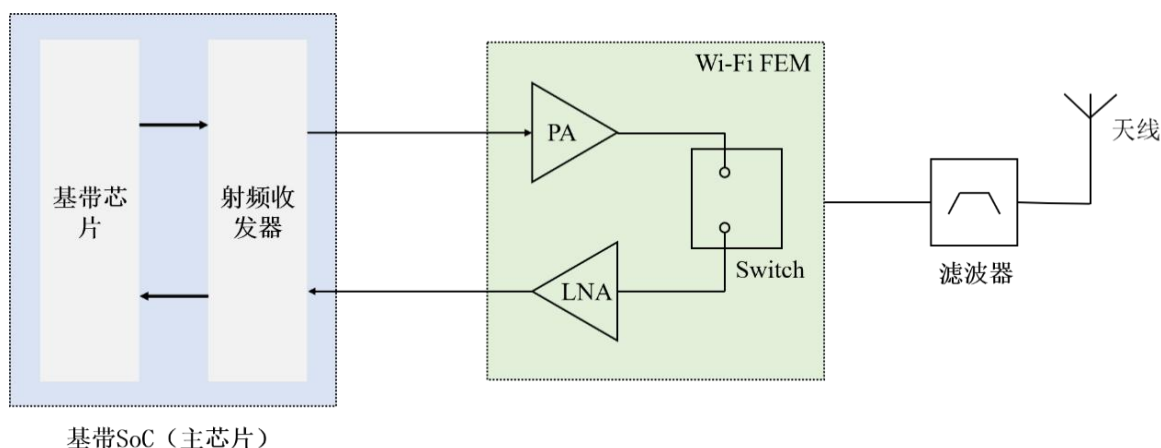
2、主要产品

近年来，得益于下游 Wi-Fi 市场的快速发展及我国芯片国产化进程的加快，公司业绩进入快速增长期。公司已成为国内领先的 Wi-Fi FEM 供应商，也是 Wi-Fi FEM 领域芯片国产化的重要参与者。

同时公司产品还包括 IoT FEM、智能车联网 V2X FEM、适配低空经济领域的无人机射频前端芯片等产品，集成了公司自主研发的 PA、LNA 及射频开关等射频前端芯片。



Wi-Fi FEM 的主要工作原理如下：在发射端，数字信号经过主芯片的调制和射频收发器的调频后进入发射链路，通过 PA 对模拟信号的功率进行放大，然后再由天线实现 Wi-Fi 信号发射。在接收端，天线接收到 Wi-Fi 信号后由 LNA 对信号低噪声放大，然后再传导至射频收发器和主芯片，将模拟信号进行解调后转换为数字信号。



Wi-Fi FEM 性能直接影响了用户使用 Wi-Fi 通信时的联网质量、上行及下行传输速度、传输距离、设备能耗等体验。Wi-Fi 是当前移动互联网、物联网时代下最重要的无线通信方式之一，随着万物互联时代的到来，Wi-Fi FEM 的市场需求日益增加，其作用也愈来愈重要。

在物联网领域，智能终端设备一般都会采用 Wi-Fi、蓝牙、ZigBee 等两种或两种以上通信方式，以提高设备联网的便捷性和兼容性，因此，公司也针对物联网（IoT）市场开发了支持蓝牙通信、ZigBee 通信等协议的射频前端芯片模组产品，即 IoT FEM，由公司自主研发的 PA、LNA 及 Switch 射频前端芯片集成，其基本原理及功能与 Wi-Fi FEM 类似。

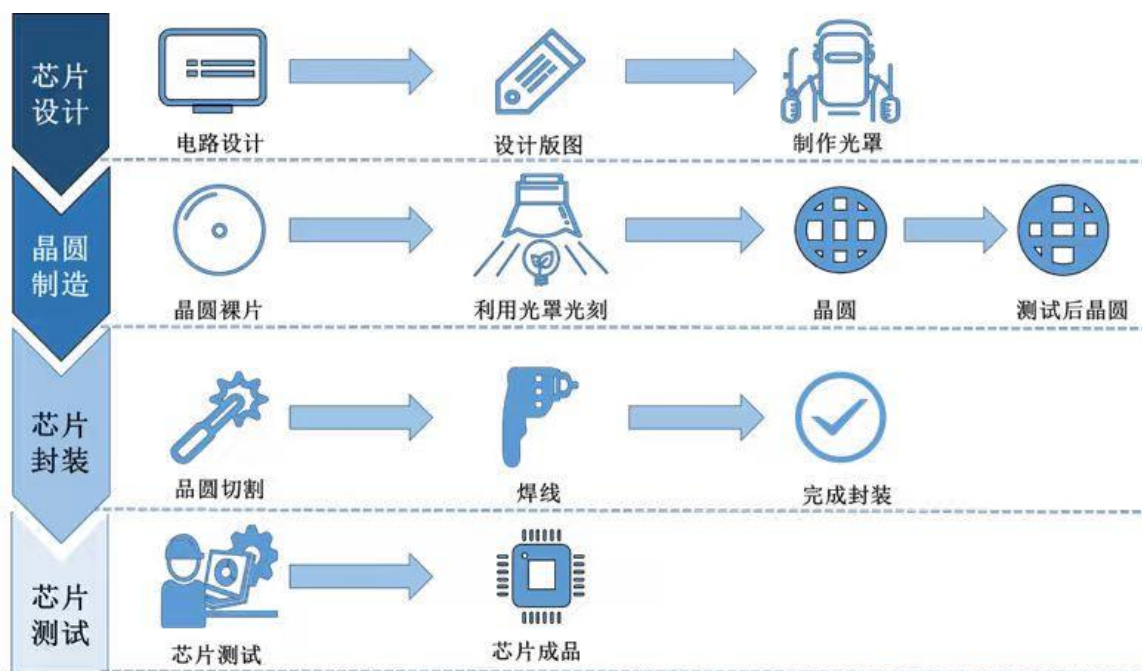
公司主要产品如下所示：

产品类别	产品系列	产品简介	主要应用领域
Wi-Fi FEM	Wi-Fi 5 系列	公司于2017年推出首款支持Wi-Fi 5协议的分立式PA芯片与全集成Wi-Fi FEM产品。采用GaAs、CMOS加工工艺、超小封装工艺，产品具备高可靠性、高线性度、高功率、低噪声等特点。	无线路由器、无线AP、光猫、CPE、机顶盒等
	Wi-Fi 6 系列	公司于2019年研发成功并于2020年量产支持Wi-Fi 6协议的集成Wi-Fi FEM产品，采用GaAs、SOI、CMOS等工艺，产品具备高集成度、高线性度、高功率、高效率等特点。	无线路由器、无线AP、光猫、CPE、机顶盒等
	Wi-Fi 7 系列	公司于2022年底推出支持Wi-Fi 7协议的集成FEM产品，采用GaAs、CMOS等工艺，产品具备高集成度、高线性度、高功率、高效率等特点。	无线路由器、无线AP、光猫、CPE、机顶盒等
IoT FEM	-	利用公司特有的高性价比RF CMOS工艺技术积累，结合砷化镓模拟电路的新技术突破，支持蓝牙协议、ZigBee、Thread、星闪、Wi-SUN、Wi-Fi Halow等协议标准的集成FEM产品，产品具备高集成度、低功耗、超低噪声、高性价比等特点。聚焦智能家居、智能电表计等应用领域。	智能蓝牙音箱、遥控器、智能安防、智能电表、智能家居等物联网产品
	-	采用GaAs、SOI、CMOS等工艺，应对低空经济、C-V2X智能车联网、超宽带UWB等应用领域，完成一系列泛IoT射频前端产品研发，满足各领域客户对高品质无线连接的需求。	低空经济、智能电表、智慧城市、车-路-人-云互联互通

2.2 主要经营模式

公司是一家专业的射频前端芯片设计企业，主要经营模式为国际集成电路行业通行的 Fabless 模式，即聚焦集成电路研发、生产与销售的无晶圆生产模式。公司集中优势资源用于射频前端芯片及模组的研发、销售环节，生产制造环节则委托独立第三方晶圆制造厂及封装测试厂商代工完成。

公司自主完成集成电路版图的设计后，将设计版图交予晶圆制造厂商，由晶圆制造厂商按照版图生产出晶圆，晶圆交由第三方封装厂商完成芯片与模组的封装环节；封装完成后，再由专业的检测厂商对芯片及模组进行性能检测，测试合格后，方可对外销售。



结合集成电路行业惯例及公司自身经营特点，公司采用直销、经销相结合的销售模式。公司直销客户主要为通信设备品牌厂商或 ODM 厂商，经销客户主要为专业的电子元器件经销商。公司经销模式又分为买断式经销和代理式经销两种模式，买断式经销主要针对境内经销商，代理式经销商主要针对境外经销商。通过直销及经销相结合的销售模式，公司既可以与下游知名品牌客户保持紧密联系，又能够充分利用经销商的销售及服务渠道，将产品推广至更多下游客户，增加产品的市场份额，拓宽产品销售的覆盖范围。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 所处行业

公司主要从事集成电路产品的研发、设计和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于软件和信息技术服务业中的“集成电路设计”（代码：6520）。根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所处的集成电路设计行业属于鼓励类产业。

(2) 行业基本特点

集成电路设计处于集成电路产业链的上游，负责芯片的开发设计。集成电路设计

行业是典型的技术密集型行业，是集成电路行业整体中对科研水平、研发实力要求较高的部分，芯片设计水平对芯片产品的功能、性能和成本影响较大，因此芯片设计的能力是一个国家在芯片领域能力、地位的集中体现之一。经过十余年“创芯”发展，国内集成电路产业呈现集聚态势，逐步形成以设计业为龙头，封装测试业为主体，制造业为重点的产业格局。在国内集成电路行业中，设计业始终是最具发展活力的领域，是我国集成电路产业发展的源头和驱动力量。2025 年中国集成电路产业在国家政策扶持下、国内需求牵引下继续保持高速增长。根据中国半导体行业协会统计，2025 年中国集成电路产业销售额 17,331 亿元，同比增长 20.2%。其中：设计业销售额为 8,261.1 亿元，同比增长 24.8%。附加值较高的设计环节销售额占集成电路行业总销售额的比例从 2016 年的 37.93% 上升到 2025 年的 47.67%，为集成电路产业链中比重最大的环节。

集成电路的下游应用领域市场广泛，随着消费电子、工业控制、智能物联、数据中心、新能源汽车等终端应用市场的不断发展，全球集成电路市场的需求量稳步提升。预计未来几年，伴随着以 AI、新能源、5G、IoT、车联网和云计算为代表的新技术的推广，更多产品和场景将需要植入相关芯片、存储器等集成电路元件，集成电路产业将会迎来进一步发展。根据 WSTS 数据，2025 年全球半导体销售额同比增长 25.6% 至 7,917 亿美元，其中全球模拟芯片市场在 2022 年达到近年高点后，2023-2024 年呈现下滑态势但 2024 年降幅收窄，2025 年逐步走出库存调整周期，实现温和复苏，全年营收同比增长 8.7%，市场规模达到 865 亿美元。

WSTS 在其 2026 年 3 月的统计数据中预计，2026 年全球半导体市场将持续高速增长，市场规模将接近万亿美元。根据 WSTS 2025 年的秋季预测，模拟芯片市场 2026 年将延续稳健增长态势，增幅稳定在 7.5%，市场规模预计达到 919.88 亿美元。增长动力方面，除工业控制等传统领域的稳定需求外，AI 技术的持续迭代、自动驾驶和机器人的快速发展，将进一步拉动模拟芯片需求，同时行业库存已降至健康水平，有望推动模拟芯片市场实现量价稳步提升。

受益于全球半导体产业链第三次转移以及国内制造业的成长，中国国内各应用领域对国产集成电路产品的使用需求日益增长，同时在中央和各级政府一系列产业支持政策的驱动下，国内集成电路行业得以快速成长。据 Omdia 2026 年 1 月最新报告，2026 年中国半导体市场规模预计将达 5,465 亿美元，同比增长 31.26%，显著高于全

球平均水平，占全球市场比重超 55%，持续稳居全球第一大半导体市场地位。

集成电路行业是支撑国民经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程。自 2000 年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展，如 2011 年国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、2017 年工信部颁布的《物联网“十三五”规划》，2020 年国务院颁布的《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，2021 年国家发改委发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等。2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》：瞄准集成电路、关键软件、人工智能等战略性前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力，增强关键技术创新能力，加快推动数字产业化。2023 年 12 月，国家发改委修订发布了新版《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，明确将“集成电路设计”等列为鼓励类发展的项目。2024 年 2 月，国务院印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，将积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单。2026 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》指出：“十五五”的主要目标之一为科技自立自强水平大幅提高，要加强原始创新和关键核心技术攻关，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。中国的集成电路产业政策旨在通过一系列综合措施，从资金、技术、人才等多个方面给予全方位的支持，构建健康、可持续发展的集成电路生态系统。这些相关政策彰显出我国在面对复杂地缘政治环境和应对逐渐加剧的贸易冲突背景下，解决国家经济发展和产业瓶颈问题的信心与决心，为我国集成电路产业持续健康发展提供了政策助力。不仅有助于提升国内半导体产业的整体竞争力，也为全球半导体行业的发展提供了重要支撑。

国际上，Skyworks、Qorvo 作为全球领先的射频前端企业，经营历史长，在收入规模、技术积累、市场地位、人才储备等方面竞争优势明显，同时通过资本运作与企业并购，在各个应用领域中均拥有较完整的产品线布局与很强的产品竞争力。在射频前端市场中，目前仍主要由 Skyworks、Qorvo 为代表的龙头厂商占据主导地位。

（3）主要技术门槛

集成电路设计行业技术门槛较高，Fabless 模式下，集成电路设计环节是企业经营最为核心的业务环节，是决定企业未来持续经营能力的关键要素。企业通过研发设计进行技术积累，形成了较高的研发及技术壁垒，构建了企业的核心竞争优势。

集成电路设计行业技术水平呈现出专业性强、难度高、技术迭代速度快、与下游应用领域紧密配合等特点，各个细分领域之间均存在较高的技术壁垒，行业内的新进入者往往需要经历较长一段时间的技术摸索和积累时期，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡，中小企业一般选择某一细分领域参与市场竞争，仅有少数国际巨头参与多领域竞争。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在 Wi-Fi 通信领域，行业内企业仍以境外厂商为主，Skyworks、Qorvo 占据半数以上市场份额，立积电子市场份额位居行业第三。在境内射频前端厂商中，公司系 Wi-Fi 领域芯片国产化主要参与者，根据能够公开获取的资料，公司 Wi-Fi FEM 销售规模处于境内厂商中较为领先的地位，但相比于境外领先厂商，销售规模相对较低，仍处于追赶地位；同时也意味着，仍有较大的市场替代空间。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处的射频前端行业与无线网络设备行业深度绑定，其发展高度依赖 Wi-Fi 通信技术的迭代演进。2026 年，行业已迈入 Wi-Fi 7 商用深化与 Wi-Fi 8 芯片发布双轨并进的关键阶段。Wi-Fi 7 技术在 2024 年完成中国国家无线电办公室的认证并纳入 3C 强制检测体系，Wi-Fi 联盟于 2024 年 7 月正式推出 Wi-Fi CERTIFIED 7 认证计划，推动市场快速普及。与此同时，行业迎来全新技术拐点：高通、联发科、博通三大巨头于 2026 年 3 月巴塞罗那世界移动通信大会（MWC 2026）同步发布 Wi-Fi 8 芯片方案，高通推出 QCS6700 平台实现 1 毫秒级超低时延与工业级 99.999% 可靠性，联发科发布 Filogic8000 系列支持 XR 与工业物联网场景并降低 40% 功耗，博通则推出 BCM4928 芯片实现 320MHz 频宽与 Wi-Fi 7 的无缝兼容。这一里程碑标志着 Wi-Fi 8 正式从标准草案进入产业落地阶段，IEEE802.11bn（Wi-Fi 8）标准草案预计于 2027 年第三季度完成，2028 年 9 月正式定稿，首批量产设备将于 2027 年第三季度面市。技术演进对射频前端芯片提出更高要求，需同时满足 320MHz 超宽频段支持、多链路聚合协同、超低幅度矢量误差等严苛指标，行业技术壁垒显著提升，加速市场集中度向具备全栈技术能力的头部厂商集中。

公司凭借在射频前端领域的持续创新，Wi-Fi 7 产品已成功获得博通、高通、联发科、瑞昱的认证，是国内唯一实现这一成绩的企业。2025 年，公司提前展开 Wi-Fi 8 芯片研发，为行业从“高速率”向“高可靠性”的升级浪潮奠定核心竞争力。Wi-Fi 新技术将赋能新产业，例如 8K A/V 流媒体、AR/VR、云游戏、全息交互式应用、工业物联网和工业 4.0、远程诊断和远程手术等应用领域，Wi-Fi 新技术将从前的“不可能”变为“可能”。

2023 年 5 月，工业和信息化部等十四部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，为行业高质量发展注入持续动力。在政策引领下，固定宽带接入网已实现从 GPON 向 10G PON 的全面升级，并于 2025 年加速向 50G PON 平滑演进，2026 年正稳步推进至 100G PON 时代，接入速率突破万兆关口，网络时延稳定降至 1 毫秒以下，显著提升网络可靠性与稳定性，为精密自动化控制、远程医疗、工业互联网等高可靠场景提供坚实支撑。伴随技术迭代，Wi-Fi 7 在 2024-2025 年已实现全行业普及，各品牌厂商相继推出 Wi-Fi 7 路由器及手机 OTA 升级方案。在这一背景下，公司的产品受到了小米、中兴通讯等国内知名终端设备厂商的青睐，成功应用于这些厂商最新的无线路由器和网关设备中，为用户提供高速、稳定的无线连接。2024 年，公司的可线性化射频前端芯片成功进入法国知名电信运营商 Free，在 Free 发布的 Wi-Fi 7 网关设备 Freebox Ultra 中，与高通 Wi-Fi 7 平台结合，完成大规模量产出货，这一合作标志着公司迈向国际市场的脚步坚实有力。伴随公司 337 调查的初裁胜诉，增强了境外客户与公司加强合作的信心，部分此前因担心产品知识产权侵权而持观望态度的国内外客户启动商务对接，进一步释放了积极的市场合作信号。2026 年 4 月 24 日（美国东部时间），公司获悉 ITC 行政法官决定基于撤诉协议，终止 Inv. No.337-TA-1413 案件调查。同时，Skyworks 也向美国加州中区联邦地区法院对处于中止状态的专利诉讼提出撤诉，并获得法院的同意。至此，Skyworks 已无条件撤回 337 调查和在美国加州中区联邦地区法院的专利诉讼，公司涉及本次 337 调查和专利诉讼的事项全部终止。

展望未来，随着无线通信技术与协议的不断发展，Wi-Fi 技术仍将继续保持其在无线通信领域的重要地位。公司将继续深化研发，加强技术创新，不断拓展国内外市场，为终端客户以及电信运营商提供更加先进、高效、可靠的射频前端芯片解决方案，以实现公司的长远发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	1,680,523,538.60	1,651,985,004.40	1.73	1,706,985,461.01
归属于上市公司股东的净资产	1,432,160,697.88	1,509,538,738.81	-5.13	1,614,862,803.35
营业收入	683,338,409.86	522,786,449.10	30.71	414,960,534.13
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	682,776,120.39	522,786,449.10	30.60	414,960,534.13
利润总额	-43,152,400.87	-74,838,565.56	不适用	3,642,982.24
归属于上市公司股东的净利润	-43,630,391.57	-76,127,407.96	不适用	9,921,406.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,600,799.80	-96,198,105.84	不适用	1,882,295.70
经营活动产生的现金流量净额	-38,458,782.67	-169,442,261.02	不适用	-982,316.66
加权平均净资产收益率（%）	-3.00	-4.83	不适用	0.94
基本每股收益（元 / 股）	-0.1041	-0.1794	不适用	0.0271
稀释每股收益（元 / 股）	-0.1041	-0.1794	不适用	0.0271
研发投入占营业收入的比例（%）	14.32	20.59	减少6.27个百分点	15.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	13,535.59	19,225.35	19,842.85	15,730.05
归属于上市公司股东的净利润	-3,020.37	547.03	-579.35	-1,310.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,307.85	-886.81	-641.43	-1,623.99
经营活动产生的现金流量净额	-2,254.64	1,807.47	-7,519.06	4,120.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							13,393
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							12,105
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
彭宇红	0	39,546,541	9.32	39,546,541	无	0	境内自然人
赵奂	0	33,870,213	7.98	33,870,213	无	0	境内自然人
上海乾晓芯企 业管理中心 （有限合伙）	0	24,418,858	5.75	24,418,858	无	0	其他
潘斌	-12,537,007	10,980,119	2.59	0	无	0	境内自然人
东方华宇资本 管理有限公司 —嘉兴鑫仍创 业投资合伙企 业（有限合伙）	-4,163,129	10,534,710	2.48	0	无	0	其他
上海觅芯企 业管理中心（有 限合伙）	0	10,232,791	2.41	10,232,791	质押	9,375,000	其他
上海科技创业 投资有限公司	0	8,200,000	1.93	0	无	0	国有法人
中移股权基金 管理有限公司 —中移股权基 金（河北雄安） 合伙企业（有 限合伙）	0	8,200,000	1.93	0	无	0	其他

北京华控投资顾问有限公司—北京华控产业投资基金（有限合伙）	0	8,139,620	1.92	0	无	0	其他
卢玫	-2,184,440	7,723,821	1.82	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、彭宇红、赵奂为一致行动人； 2、上海乾晓芯企业管理中心（有限合伙）、上海觅芯企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台，两家企业的执行事务合伙人均为上海萌晓芯信息科技有限公司，彭宇红与赵奂各持有上海萌晓芯信息科技有限公司 50%股权。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司回购专用证券账户持股 5,434,836 股，占公司总股本的比例为 1.28%。

存托凭证持有人情况

适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

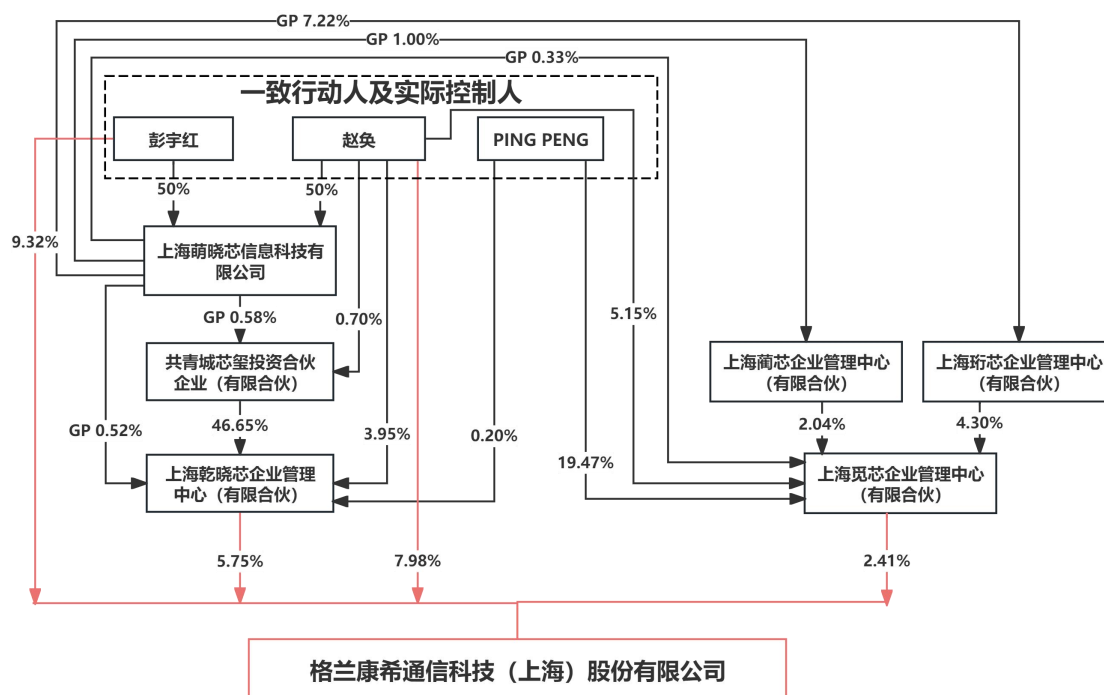
适用 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见以下内容：

详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用